

103-2 大葉大學 選課版課綱

基本資料

課程名稱	電子封裝概論	科目序號/代號	2262 / MAB4003
必選修/學分數	選修 /3	上課時段/地點	(三)BCD / B309
授課語言別	中文	成績型態	數字
任課教師 / 專兼任別	鄭江河 / 專任	畢業班/非畢業班	
學制/系所/年班	進修學士班 / 機械與自動化工程學系 / 4年1班		

課程簡介與目標

電子封裝是半導體製造產業之後段製程，在本課程除教授傳統的塑膠構裝、陶瓷構裝、捲帶自動接合外，也介紹目前新型構裝技術，如覆晶、球陣列式構裝、晶片形構裝及異方性導電膠。









課程大綱

1 前言 2 聯線技術 3 塑膠構裝 4 陶瓷構裝 5 薄/厚膜技術 6 捲帶自動接合 7 覆晶接合 8 異方性導電膠 9 新型構裝技術

基本能力或先修課程

半導體製程、微機電系統概論

課程與系所基本素養及核心能力之關連

-  認識時事議題，瞭解工程技術對環境、社會及全球的影響
-  具有基礎數學及工程知識之執行能力
-  具有執行實驗與詮釋數據之實務能力
-  具有執行機械與自動化工程實務之能力
-  具有使用工程領域設計與製造等軟體之應用能力
-  具有專案管理、領域整合、有效溝通與團隊合作的能力
-  在工程領域相關產業方面，具備整合性實務問題之解決能力
-  具備敬業樂群與終身學習之態度

